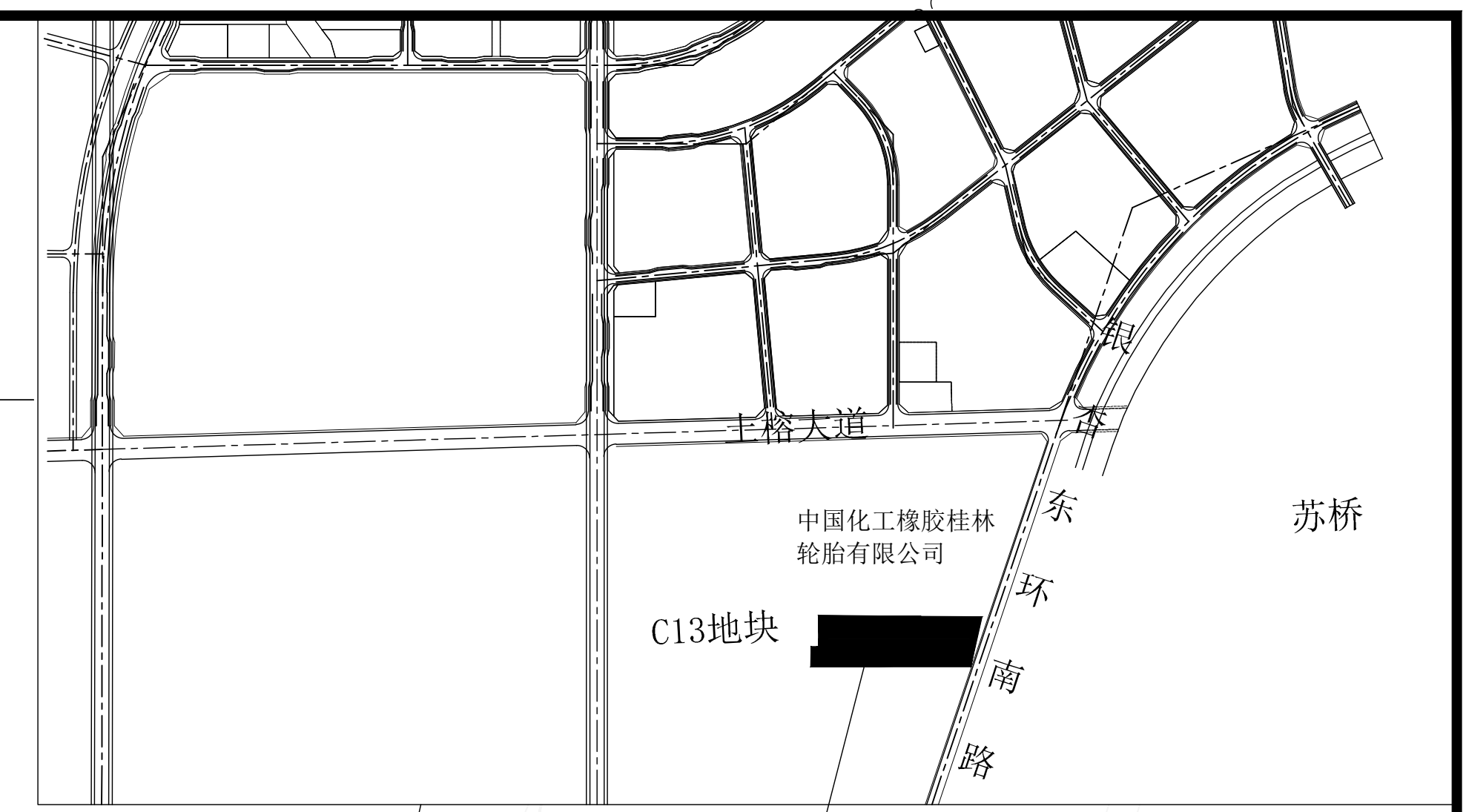
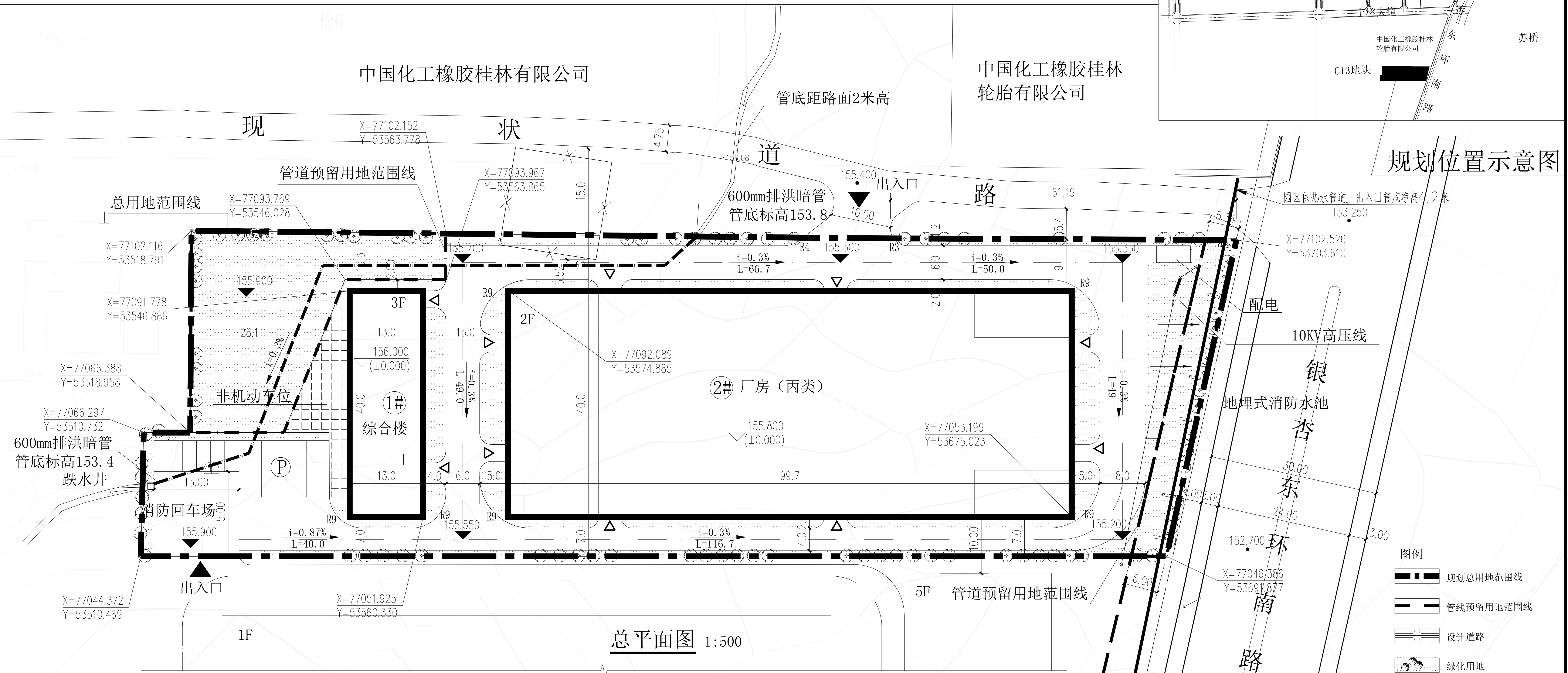


# 桂林有联电子有限公司导电硅胶连接器及产品多元化项目厂区 修建性详细规划



规划位置示意图



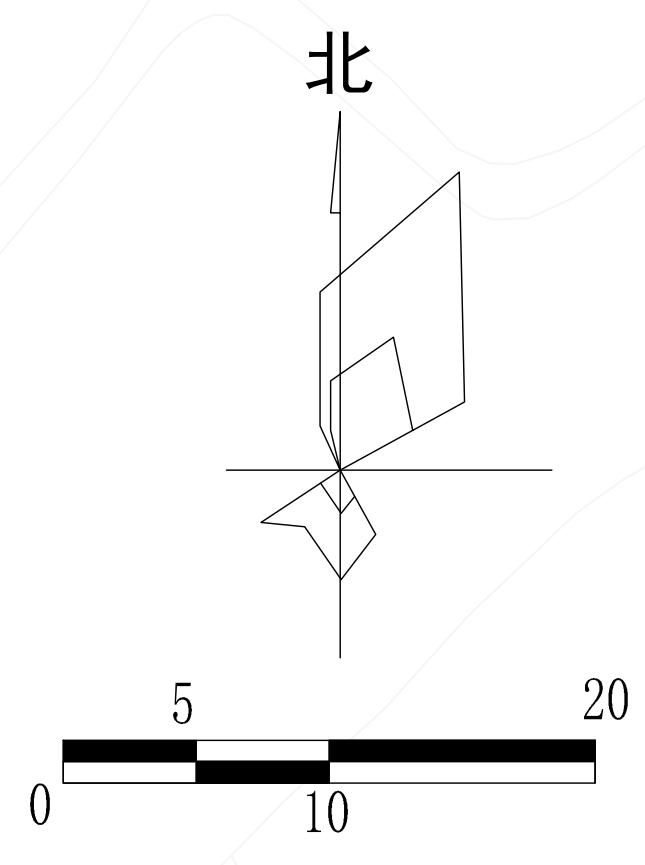
总平面图 1:500

序号	名称	建筑基底面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	计容建筑面积 (m <sup>2</sup> )	耐火等级	火灾危险性	层数	高度
1	①综合楼	520	1920	1920	二级		三层	12米
2	②厂房	3988	8300	8300	二级	丙类	二层	9米
总计		4508	10220	10220				

序号	名称	面积	单位	规划条件
1	规划总用地面积	10324.26	m <sup>2</sup>	
2	管网预留用地面积	1299.28	m <sup>2</sup>	
3	规划净用地面积	9024.98	m <sup>2</sup>	
4	总建筑面积	10220	m <sup>2</sup>	
5	计容建筑面积	10220	m <sup>2</sup>	
6	建筑基底面积	4508	m <sup>2</sup>	
7	容积率	1.13		≥1.1
8	建筑系数	49.95	%	≥35%
9	绿地面积	1250	m <sup>2</sup>	
10	绿地率	13.85	%	≤20%
11	道路广场面积	3266.98	m <sup>2</sup>	
12	机动车位	16	个	
13	非机动车位	147	个	
14	行政办公及生活设施用地面积比例	5.76	%	≤7%

注：大车为4个，按当量小汽车计算为10个。

**规划说明:**  
 1. 设计依据:  
 ① 桂林市苏桥工业园总体规划 (2009-2030)  
 ② 苏桥园入园企业建筑风格规划控制  
 ③ 苏桥园入园企业建筑规划规定  
 ④ 甲方提供的设计任务书及设计合同  
 ⑤ 1:1000地形图  
 ⑥ 建筑设计防火规范GB 50016—2014  
 2. 本图为桂林有联电子有限公司导电硅胶连接器及产品多元化项目厂区修建性详细规划, 用地位于桂林市苏桥工业园C13地块内, 整个用地面积为10324.26平方米。  
 3. 用地现状中热力管底比市政道路标高约0.5米, 本次规划厂区道路与热力管道之间进行绿化放坡设计。  
 4. 本图采用苏桥坐标系, 国家高程系, 尺寸标注单位为米, 标注尺寸为外墙尺寸。



- 图例
- 规划总用地范围线
  - 管线预留用地范围线
  - 设计道路
  - 绿化用地
  - 出入口
  - 规划建筑物
  - 拆除建筑物
  - 停车场
  - R9 道路转弯半径
  - 建筑出入口位置

桂林市工业设计研究院 工程设计资质: 乙级 证书编号: A245003867 规划资质: 丙级 证书编号: [桂]城规编 (143304)	项目名称: 导电硅胶连接器及产品多元化项目 厂区修建性详细规划		建设单位: 桂林有联电子有限公司
	审定: 黄东林 审核: 姜林 项目负责人: 姜林 专业负责人: 姜林	设计: 陈涛 方案: 陈涛 制图: 陈涛	校对: 林开仁 图别: 规划 图号: GH-01 日期: 2018.09